



Grinding Wheels

# GS08SERIES

## 实现高质量SiC 晶圆研磨的研磨轮

### 采用多孔陶瓷结合剂固定磨粒，以实现高质量的SiC晶圆研磨

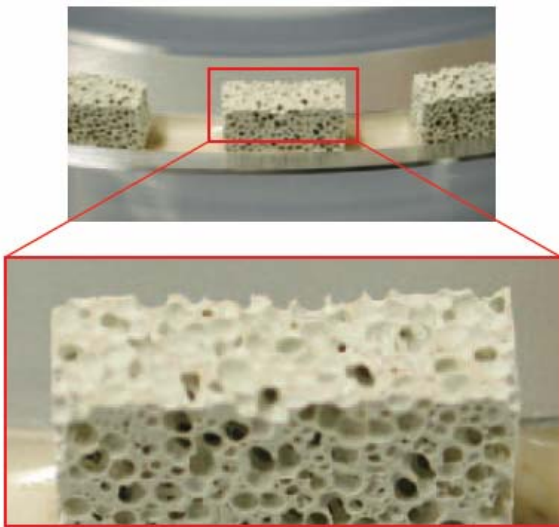
GS08系列研磨轮，是针对高硬度的SiC晶圆研磨，采用磨屑排出能力与研磨水供给能力皆优的新开发多孔陶瓷结合剂固定磨粒，以研磨加工实现接近于抛光的表面粗糙度。可对贴附于胶膜上的芯片进行研磨，因不需将蜡贴附至基板（或自基板剥除），实现比研磨浆制程（Slurry Process）简单的操作程序。

- 以固定磨粒研磨，实现接近抛光的表面粗糙度
- 可对贴附于胶膜上的芯片进行研磨，制程较简单
- 不需研磨浆（Slurry）的制程，可减轻环境负荷



### ■多孔陶瓷结合剂

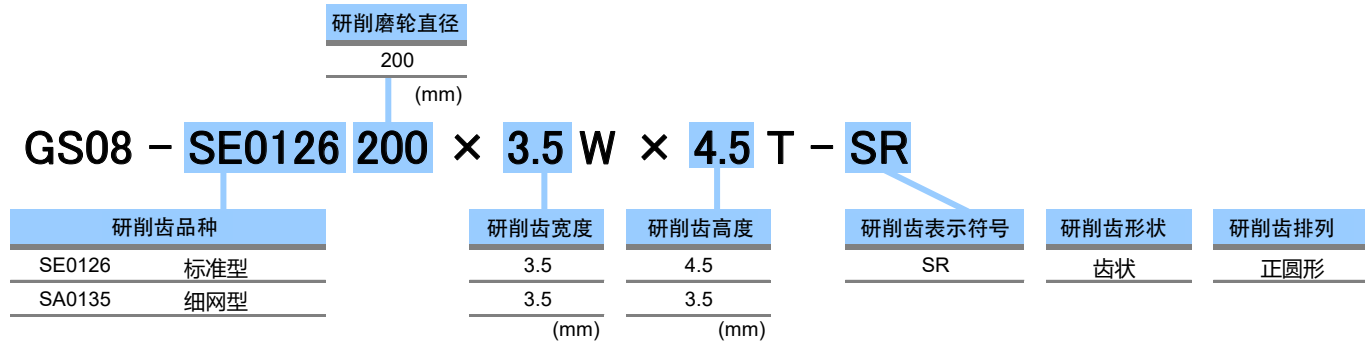
GS08系列采用原创新开发的多孔陶瓷结合剂。



加工对象

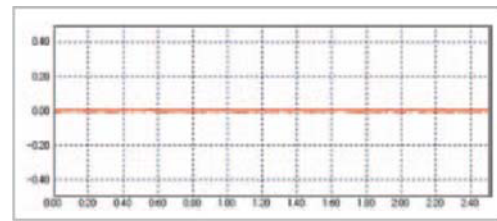
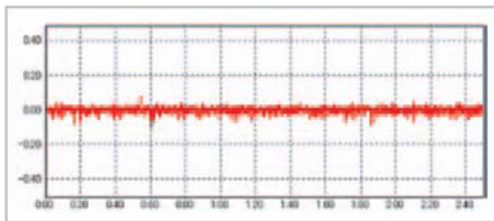
碳化硅（SiC）氧化铝陶瓷、氮化硅、其他材料

技术规格



实验结果

■ SiC研磨时的表面粗糙度



使用磨轮	SE0126 (标准型)	SA0135 (细网型)
Ra (μm)	0.011	0.001
Ry (μm)	0.115	0.009

工作物 : ø3° SiC晶圆  
测量仪器 : 接触式表面粗糙度测量仪

本公司的所有产品都已加入产品赔偿责任保险。

下订单时

在下订单时, 请用户将产品的名称、外径、研削磨轮直径及数量通知本公司。另外在初次订购时, 本公司销售窗口会根据不同加工要求, 协助用户选择适合的产品。届时请一并提供研削材料、尺寸、形状、所用设备(装置)及其它相关加工条件等数据。  
· 为了改进产品, 本公司可能在未通知用户的情况下, 就对产品规格进行变更, 因此请仔细核对规格后再下订单。



为了安全使用本公司的各种产品

为了预防发生因研削磨轮、切割刀片(以下通称精密加工刀具)的破损而造成的各种事故和人身伤害, 请严格遵守下列各注意事项。

- 请使用安全挡板(包括喷嘴外壳或外盖)。
- 在使用注有限制旋转数的精密加工刀具时, 请不要超出其规定的旋转数范围。
- 在安装精密加工刀具时, 请遵照设备(装置)使用说明书的规定, 正确地进行安装。
- 请不要使精密加工刀具掉落在地上, 或发生碰撞。
- 在每次使用精密加工刀具前必须先进行检查, 如果有缺口或其它破损, 请停止使用。
- 在开始使用前, 请先仔细阅读相关设备(装置)的使用说明书。
- 请不要使用经过改装的设备(装置)。
- 请不要使用不符合设备(装置)指定尺寸的精密加工刀具。
- 除了研削、切割及切削作业以外, 请不要使用在其它用途。
- 在使用湿式研削、切割用精密加工刀具时, 请使用冷却液。